

TECHNOLOGIE

RÉSINES: EPOXY GLOB TOP / UV GLOB TOP
SILICONE
UNDERFILL
MASSE DE REMPLISSAGE

SUBSTRATS: CÉRAMIQUE COUCHE ÉPAISSE
FR4, FR5, G10, G11, ROGERS
FLEX, FLEX RIGIDE, IMS
PYREX
...

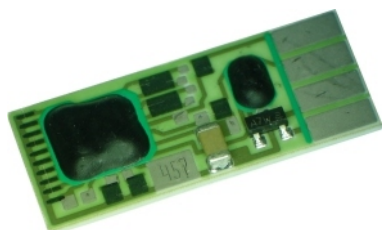
COULEURS: TRANSPARENT
OPAQUE
NOIR
...

PROCESS: MANUEL
AUTOMATIQUE

LE CHOIX DU TYPE DE RÉSINE ET LE PROCESSUS DE FABRICATION À ADOPTER POUR LA PROTECTION DES MODULES SONT DÉFINIS EN COLLABORATION AVEC LE CLIENT, CONFORMÉMENT AUX SPÉCIFICITÉS DES PRODUITS.

TECHNIQUES DE GLOB TOP

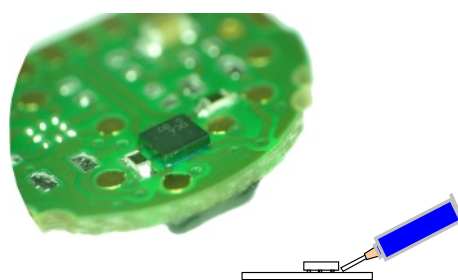
ENROBAGE



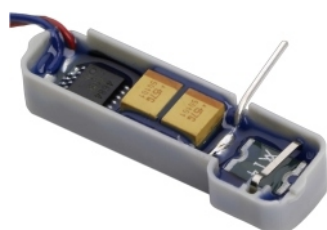
DAM & FILL (CADRE & REMPLISSAGE)



UNDERFILL (FLIP-CHIP, CSP, BGA)



MASSE DE REMPLISSAGE (RENFORT ET PROTECTION)



HYBRID SA EST À MÊME D'ENROBER LES MODULES MICRO-ÉLECTRONIQUES SELON LES SPÉCIFICATIONS DE FORMES, DE HAUTEURS MINIMUM ET MAXIMUM. LE PERSONNEL QUALIFIÉ, ASSISTÉ OU NON DE ROBOTS DE DISPENSING, EST EN MESURE DE SATISFAIRE AUX PLUS GRANDES EXIGENCES DES PRODUITS.